

杭州士兰微电子股份有限公司

关于控股子公司投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：年产 720 万块汽车级功率模块封装项目。
- 投资金额：项目总投资为 30 亿元。
- 本次投资事项需提交股东大会审议，并报有关部门批准。
- 相关风险提示：当前新能源产业飞速发展，但如受到宏观经济、政策支持、技术演进等因素的影响，市场需求可能会阶段性不达预期；同时，如未来行业竞争加剧，项目公司将面临一定的经营管理风险。

一、投资概述

（一）为进一步提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，满足日益增长的市场需求，公司拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）投资建设“年产 720 万块汽车级功率模块封装项目”，项目总投资为 30 亿元。

（二）公司于 2022 年 6 月 13 日召开了第七届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于成都士兰投资建设项目的议案》。本投资事项需提交股东大会审议，并报有关部门批准。

（三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

- 1、项目名称：年产 720 万块汽车级功率模块封装项目
- 2、实施主体：成都士兰半导体制造有限公司
- 3、建设地点：四川省成都市金堂县淮口街道成都-阿坝工业集中发展区士芯路 9 号成都士兰厂房内
- 4、建设内容：新建汽车级功率模块封装生产线，实现新增年产 720 万块汽车级功率模块的封装能力。

5、建设周期：本项目建设周期为 3 年。

6、项目总投资及资金来源：本项目总投资为 30 亿元。资金来源为企业自筹。

7、项目效益：根据成都士兰财务部初步测算，本项目达产后预计新增年销售收入（不含税）277,168 万元，新增年利润总额 30,769 万元，内部收益率（税后）为 14.3%，静态投资回收期（含建设期）为 5.3 年。

8、可行性分析：（1）本项目符合国家战略性新兴产业发展规划和集成电路发展战略；（2）新能源汽车对功率半导体产品的需求持续快速增长，国产芯片替代空间非常广阔；（3）成都士兰的功率模块封装工艺技术水平 and 生产能力已具有相当实力，生产效率高，产品性能稳定，能够保障本项目的顺利运行。

9、项目审批手续：本投资事项需提交股东大会审议，并报有关部门批准。

三、投资项目实施主体的基本情况

1、公司名称：成都士兰半导体制造有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、成立时间：2010 年 11 月 18 日

4、住所：成都市金堂县淮口街道成都-阿坝工业集中发展区士芯路 9 号

5、注册资本：120,000 万元

6、法定代表人：陈向东

7、营业期限：2010 年 11 月 18 日至 2030 年 11 月 17 日

8、经营范围：集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售及相关技术转让；相关的原材料、机械设备的销售(经向环保部门排污申报后方可经营)；货物进出口和技术进出口。（法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

9、股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	杭州士兰微电子股份有限公司	84,000	货币	70.00%
2	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	32,000	货币	26.67%
3	阿坝州振兴产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000	货币	3.33%
合计		120,000	--	100%

以上所有股东的出资均已全部实缴到位。

10、财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，成都士兰经审计的总资产为 150,351

万元，负债 22,662 万元，净资产 127,689 万元。2021 年营业收入为 28,348 万元，净利润 3,251 万元。

截至 2022 年 3 月 31 日，成都士兰未经审计的总资产为 153,234 万元，负债为 23,952 万元，净资产为 129,282 万元。2022 年 1-3 月营业收入为 10,948 万元，净利润为 1,593 万元。

四、投资事项对上市公司的影响

本项目符合国家产业政策，属于重点鼓励建设的项目。本项目的实施符合公司的发展战略和长远规划，有利于进一步提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，加快实现汽车级功率模块的产业化，完善集成电路产业链布局，增强核心竞争力，满足日益增长的新能源领域的市场需求，推动公司主营业务持续增长。

五、项目投资的风险分析

1、行业和市场风险

当前新能源产业飞速发展，市场对汽车级功率模块的需求量迅速放大，但新能源产业的发展受到宏观经济、政策支持、技术演进等因素的影响，可能会阶段性不达预期。

针对行业和市场风险，公司将充分发挥 IDM 模式的优势，加强芯片生产线和模块封装线的协同，并通过加强与下游大客户的合作，不断开发出具有世界先进水平的产品，稳步扩大产能，持续提升市场份额。

2、经营管理风险

未来随着新能源领域市场的扩大，不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品的价格产生不利影响。同时新能源汽车厂商对车规级产品要求严苛，项目公司的经营管理将面临新的挑战。

针对经营管理风险，公司将通过吸引人才，加快创新，优化流程，持续提升经营管理水平；同时不断提高生产工艺技术水平，加强成本控制，保障产品质量。此外，公司将加强产品系列化开发，提高产品附加值。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日